

半導体部会 半導体技術委員会
半導体実装・製品技術専門委員会
2008年度 成果報告会

「大きな転換期を迎える JEITA 活動」
- 不況に打ち勝つための戦略的な標準化への取組み -

(社)電子情報技術産業協会 半導体部会 半導体技術委員会傘下の半導体実装・製品技術専門委員会では、この度委員会活動成果報告会として「大きな転換期を迎える JEITA 活動 - 不況に打ち勝つための戦略的な標準化への取組み - 」を開催致します。半導体メーカーや関連メーカーの方々を対象としておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。また、終了後懇親会も催しますので、併せてご参加ほどお願い致します。

日 時 2009年3月18日(水) 13:45 ~ 19:00

会 場 ベルサール神保町 Room1

東京都千代田区西神田 3-2-1 (住友不動産千代田ファーストビル南館3階)
03-5275-7258 (電子デバイス部直通)

案内図 http://www.bellesalle.co.jp/bs_jimbocho/images/shikihai.html

参加費 無料
定員 80名(定員になり次第締切ます)
申込期限 2009年3月13日(金)

申込方法 下記申込書にご記入のうえ、E-mail または FAX にてお申込み下さい。

申 込 先 (社)電子情報技術産業協会 電子デバイス部(岩淵・富澤)

〒101-0065 東京都千代田区西神田 3-2-1

TEL: 03-5275-7258

FAX: 03-5212-8121

E-mail: device2@jeita.or.jp

(社)電子情報技術産業協会
電子デバイス部 岩淵・富澤宛

E-mail: device2@jeita.or.jp

FAX 03-5212-8121

半導体実装・製品技術専門委員会 2008年度成果報告会参加申込書
(2009年3月18日開催)

会社名 _____

代表者名および TEL _____

氏名: _____

TEL: _____

氏名	所属	報告会	懇親会

報告会及び懇親会の出欠は、×でお示し下さい。

半導体部会 半導体技術委員会
半導体実装・製品技術専門委員会 2008 年度 成果報告会プログラム

大きな転換期を迎える JEITA 活動
- 不況に打ち勝つための戦略的な標準化への取組み -

- 日 時 2009年3月18日(水) 13時45分～19時00分
場 所 ベルサール神保町 Room1
東京都千代田区西神田 3-2-1 (住友不動産千代田ファーストビル南館3階)
- 13:45～13:50 **開会の挨拶** 樋口 泰之 氏 半導体実装・製品技術専門委員会委員長
(ローム株)
- 13:50～14:00 **半導体実装・製品技術専門委員会功労賞 表彰式**
- 14:00～14:30 **半導体パッケージ技術小委員会 報告**
「半導体パッケージ技術小委員活動報告」
富田佳宏 氏 半導体パッケージ技術小委員会主査 (パナソニック株)
- 「集積回路 PKG-SC 活動を振り返って」
小塩 康弘 氏 集積回路 PKG-SC 委員 (株)東芝
- 14:30～15:00 **半導体信頼性技術小委員会 報告**
「半導体信頼性技術の標準化状況」
田中 政樹 氏 半導体信頼性サブコミティ主査 (株)ルネサステクノロジ
- 15:00～15:15 コーヒーブレイク
- 15:15～15:30 **個別半導体製品技術小委員会 報告**
「JEITA 個別半導体規格の動向について」
青木 芳雄 氏 個別半導体小委員会副主査 (ユーディナ デバイス株式会社)
- 15:30～16:00 **集積回路製品技術小委員会 報告**
「半導体 EMC のモデリング」
市川 浩司 氏 半導体 EMC サブコミティ副主査 (株)デンソー
- 「低電圧化・ニーズ多様化に対する標準化への取組み」
星野 靖陽 氏 メモリサブコミティ主査 (NECエレクトロニクス株)
- 16:00～16:10 休 憩
- 16:10～17:10 **ご来賓講演**:小川 紘一 氏 (工学博士/東京大学ものづくり経営研究センター)
- 17:10～17:25 **ご来賓講演**:【経済産業省 予定】
- 17:25～17:30 **閉会の挨拶** 富田 佳宏 氏 半導体パッケージ技術小委員会委員長
(パナソニック株)
- 18:00～19:30 **懇親会** (場所: JEITA 会議室、会費無料)